### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-263438

(43) Date of publication of application: 26.10.1990

(51)Int.Cl.

H01L 21/304 H01L 21/306

(21)Application number: 01-085023

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

03.04.1989

(72)Inventor: AIHARA KAZUHIRO

NAKAJIMA YUICHI

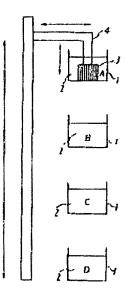
**MURAKISHI TAKEO** 

#### (54) MANUFACTURING APPARATUS OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the area of a whole manufacturing apparatus, by constituting a plurality of liquid tanks so as to be vertically stacked, and transferring semiconductor wafers between the liquid tanks by using an elevator (convever).

CONSTITUTION: In a liquid tank 1 warmed up by a heater, a lot of semiconductor wafers 3 are dipped, and then cleaned and etched by solution 2. In the first place, the semiconductor wafers 3 are dipped in solution A2 and cleaned and etched: after this process is ended, the semiconductor wafers 3 are dipped in the next liquid tank 1 of solution B2, and cleaned and etched; after this process is ended, the wafers are transferred in the liquid tank 1 of solution C2; the wafers are successively transferred in solution D, E.... The transferring of the wafers between the liquid tanks are executed by using a conveyer 4. Since various kind of liquid tanks are constituted so as to be vertically stacked in this manner, the area of a manufacturing apparatus occupied by the liquid tanks can be reduced.



## ◎ 公開特許公報(A) 平2-263438

Int, Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)10月26日

H 01 L 21/304 21/306 3 4 1 T

8831-5F 7342-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

会発明の名称 半導体装置の製造装置

②特 願 平1-85023

②出 願 平1(1989)4月3日

@発明者相原

一 洋 兵庫県伊

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

**加発明者中島** 

裕一

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑩発 明 者 村 岸 武

夫

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 增雄

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置の製造装置

2. 特許請求の範囲

半導体装置の熱酸化、拡散を行なう工程の削工程で、外周囲に加熱手段を設けた各種溶液槽内で半導体基板を水を含めた各種溶液により洗浄、エッチングさせる製造装置において、各種溶液の入っている液槽を縦に並べるようにしたことを特徴とする半導体装置の製造装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は半導体装置の製造装置に関し、特に 半導体装置のための洗浄・エッチング装置の改良 に係るものである。

〔従来の技術〕

従来の半導体装置のための洗浄・エッチング装置の概要構成を第 4 図。第 5 図に示す。

図において、洗浄・エッチングするための各容 液(2)の入っている液槽(1)間を半導体ウェハ(3)が鍛 送機(4)によって横に移動できるようにされていた。 次に動作について説明する。

ヒーター (図示せず) によって温められた溶液 槽(1)内に、多数個の半導体ウエハ(3)を侵渡させ、 各溶液(2)により、洗浄・エッチングするようにさ れている。

第4図は半導体ウェハ(3)を侵潰する前の状態を示し、第5図は半導体ウェハ(3)を各溶液(2)内に侵潰した後で、溶液(2)を作用させて半導体ウェハ(3)の洗剤・エッチングさせている状態を示している。

最初に、溶液Aに半導体ウェハ(3)を侵潰させ、 洗浄・エッチングを行ない、この工程終了後次の 溶液B(2)の液槽(1)に半導体ウェハ(3)を侵潰させ洗 浄・エッチングを行ない、終了後溶液С(2)の液槽 (1)に移り、次に溶液D,E…へと移っていく。な お、各液槽(1)間の移動は搬送機(4)を用いて行なう。

(発明が解決しょうとする課題)

従来の洗浄・エッチング装置は以上のように構成されていたので、各液槽が横に順次並べている ため多数の溶液槽を設置する場合半導体装置の製 造装置の面積が広くなってしまうという問題点が あった。

この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、多数の被槽を設置する場合に全体の製造装置の設置面積を小さくすることのできる半導体装置の製造装置を得ることを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

この発明に係る半導体装置の製造装置は複数の 液槽を縦に積み重ねるように構成したもので、各 液槽間の半導体ウェハの移動はエレベーター (搬 送機)を用いて行なう。

(作用)

この発明における液槽は縦に積み重ねるようにすることにより、全体の製造装置の面積を小さくすることができる。

〔発明の実施例〕

以下、この発明の一実施例を図について説明する。

第1図、第2図および第3図はこの発明の第1、

て洗浄・エッチングを行ない、終了後溶液 C (2) の液槽(1) に移り、順次溶液 D・E…と移っていく。なお、各液槽(1) 間の移動は搬送機(4) を用いて行なう。

なお、上記実施例では半導体ウェハ(3)を搬送機(4)によって移動させた場合を示したが、溶液(2)の入った液槽(1)を搬送機(4)によって移動させてもよい。この第2の実施例を第2図に示す。

また、被槽(1)を搬送機(4)によって回転するように移動させて、被槽(1)が半導体ウェハ(3)の真下に到産したときに、半導体ウェハ(3)を搬送機(4)により下に移動させ溶液(2)内に侵潰させる。次に順番に液槽(1)を回転させて洗浄・エッチングさせてもよい。この第3の実施例を第3図に示す。

この他の実施例の半導体装置の製造装置は上記 実施例と同様の効果を奏する。

〔発射の効果〕

以上のようにとの発明によれば、各種液槽を縦 に積み重ねるように構成したので、液槽の占める 製造装置の面積を小さくすることができ、液種を 第2 および第3 の実施例である半導体装置の製造 装置の構成を示す断面説明図で、前記従来のもの と同一部分は同一符号を付してある。

第1 図において、洗浄・エッチングするための各溶液(2)の入っている液槽(1)間を半導体ウェハ(3)が搬送機(4)によって縦に移動できるようにしたものである。

この第1 実施例の製造装置では各液槽(1)を縦に 積み重ねた構成となっているため、液槽(1)を複数 個連続して並べた場合でも、製造装置の占める面 積は変わらない。従って液槽(1) 1 個当りの製造装置の面積は小さくなる。

なお、個々の液槽(1)では前記従来のものの動作と全く同じ動作が行なわれている。ヒーター(図示せず)によって温められた液槽(1)内に、多数個の半導体ウェハ(3)を侵瀆させ、溶液(2)により、洗浄・エッチングさせるようにしている。

最初に溶液 A (2) に半導体ウェハ(3) を侵渡させ、 洗浄・エッチングを行ない、この工程終了後、次 の溶液 B (2) の液槽 (1) に半導体ウェハ(3) を侵渡させ

多く設けることができ、液槽間の混入によるだれ を防ぐため、同一液槽を複数個連続して並べることができ、また作業効率を高めることができるな どの利点がある。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例による半導体装置の製造装置の構成を示す断面説明図、第2図および第3図はこの発明の他の実施例を示す半導体装置の製造装置の断面説明図、第4図および第5図は従来の半導体装置の製造装置の構成を示す断面説明図である。

図において、(1) は液槽、(2) は各裕液、(3) は半導体ウェハ、(4) は搬送機を示す。

なお、図中、同一符号は同一、または相当部分 を示す。

代理人 大岩增雄

# 特閒平2-263438(3)

